

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

江苏灿勤科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2024年6月11日-13日)

编号：2024-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议、券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	中邮证券、君子兰资本
时间	2024年6月11日-13日
地点	线上会议 灿勤科技会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：陈晨女士 证券事务代表：钱志红女士
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：告知保密义务 第二部分：问答环节 1、问：公司的产品能用在5.5G基站上吗？ 答：公司最新款的陶瓷介质滤波器能够广泛适用sub-6GHz频段内的各应用场景，包括4G、5G、5.5G等FDD架构通信网络。公司将持续跟踪5.5G、6G技术发展动态，做好相关的预研及技术储备，与客户保持密切的互动，跟随客户技术发展，积极参与客户的解决方案。谢谢。 2、问：公司的产品有用到卫星上吗？ 答：公司的产品有应用于星网计划，公司将与客户保持密切的互动，跟随客户技术发展。谢谢。 3、问：想问下高端陶瓷器件的技术壁垒主要哪些？

答：电子陶瓷元器件的研发、生产涉及材料科学、电子技术、机械技术、化学等众多领域，研发难度大，设计难度高，生产工艺复杂，属于典型的技术密集型产业。

① 材料壁垒

自有粉体配方是电子陶瓷元器件厂商的核心竞争力。电子陶瓷元器件的粉体配方必须满足高精细度、高纯度、高分散性、化学均一、高结晶度等一系列严格的技术要求，其研发过程往往需要长期的实验、检测和数据积累、分析，研发周期较长。相关配方均属于各企业的商业秘密，难以进行逆向工程和复制，行业进入者难以复制现有企业的竞争优势。

② 工艺壁垒

电子陶瓷元器件的生产加工需要有较强的制备能力。成熟的生产工艺依靠长期的经验积累，需要在实践中不断摸索才能取得，如生产过程中的烧结工艺、成型工艺等均需要长周期、高投入的实践经验摸索。不成熟的生产工艺生产出的陶瓷产品容易碎裂、变形、收缩，产品的良率较低，导致生产成本更高。企业需要建立起一整套严格的工艺流程控制、检测手段，从而保证生产的标准化、系列化，从零开始积累的难度较大。厂家在工艺研发成功后，均会采用专利、商业秘密等手段加以保护，潜在竞争者很难在短期内取得能满足市场需求的高性能产品的生产工艺。

③ 创新研发壁垒

电子陶瓷元器件下游应用领域不断扩大，由于下游行业的快速发展，技术更新速度较快，对电子陶瓷元器件厂商的创新能力有较高的要求，上游元器件厂商需要具备独立的研发平台、先进的研发设备、较强的研发团队、较快的研发响应速度。如果缺乏较强的研发团队、自主核心技术、生产技术管理能力，将缺乏持续的研发创新能力，难以满足快速变化的市场需求，无法在市场上长期生存和发展。

综上所述，电子陶瓷元器件行业的新进入者难以在短时间内掌握粉体配方等核心技术，生产工艺也需要较长时间的积累，在无核心技术、研发平台、研发团队的情况下难以适应市场需求的快速变化，进入壁垒较高。谢谢。

4、问：目前公司募投项目“新建灿勤科技园项目”进展情况如何？

答：公司募投项目“新建灿勤科技园项目”分三期建设。一期工程“新建 HTCC、LTCC 产品线项目”目前已全面完成封顶，幕墙和外立面装修工程也已经全部完工，部分厂房已完成转固，达到预定可使用状态；二期工程“新建电子陶瓷研究院项目”已于 2023 年开工，预计 2025 年上半年竣工；三期工程“新建介质波导滤波器产能扩张项目”计划于今年下半年动工，预计 2025 年竣工。谢谢。

5、问：公司 2023 年及 2024 年第一季度的经营业绩情况？

答：2023 年，公司财务状况良好，总资产 23.50 亿元，较年初增加 1.41%，归属于上市公司股东的净资产 21.36 亿元，较年初增加 1.42%，主要系本年归属于上市公司股东的净利润所致。2023 年，公司实现营业收入 36,989.36 万元，较上年同期增长 7.16%，主要系公司以技术创新推动产业发展，持续加大研发投入，持续开发新的产品型号，不断开拓新的市场，营业收入持续增长；归属于母公司所有者的净利润 4,673.56 万元，较上年同期下降 40.55%，主要原因是公司收到的政府补助与上年同期相比减少 3,376.36 万元，理财收益与上年同期相比减少 549.27 万元，导致净利润变动较大。扣除上述非经常性损益的影响，公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少 55.44 万元，主要系公司的销售费用、研发费用及管理费用有所增加。

2024 年第一季度营业收入 8,160.97 万元，较上年同期减少 5.80%，归属于上市公司股东的净利润 1,457.35 万元，较上年同期增长 43.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 941.96 万元，较上年同期增长 117.88%，公司本期净利润上升主要原因包括：1、对比的去年同期净利润基数较低；2、公司持续开发新产品、拓展新市场，本期产品结构的变化带来主营业务毛利率有所提升；3、存款利息的增加导致财务费用减少；4、股份支付费用的减少导致管理费用减少。谢谢。

6、问：公司 HTCC 产品的进展情况？

答：公司目前已建成完整的 HTCC 自动化设备产线，建立了 HTCC 产品线端到端的能力。从产品设计、陶瓷材料制备、瓷体成型、烧结、表面金属化、钎焊组装、测试检验、试验分析等可全部由公司内部完成。在 HTCC 陶瓷材料领域，根据不同应用场景，公司已开发出 92/95/96/99 氧化铝等成熟配方 8 种，并着手于高导热氮化铝、氮化硅陶瓷材料研发。在 HTCC 制造工艺领域，公司已实现单层厚度最小 0.1mm，最小孔径 0.1mm，最小线宽 50um，最小线距 50um 的极限工艺能力，适用于高精度 HTCC 产品制造。在 HTCC 封装产品形态方面，公司已完成微波 SIP、微波功率管壳、CMOS、光通信、光耦合器封装、CPGA、CBGA、CQFN、CLCC、CSOP、CQFP 等系列封装产品的开发和送样；其中微波 SIP 等产品已取得客户认可，开始小批量交付使用。在陶瓷基板产品形态领域，公司数款 DPC 陶瓷基板已完成小批量交付验证。

公司控股子公司频普半导体目前已具备薄膜电路及相关薄膜 MEMS 无源器件的批量生产能力，部分毫米波薄膜无源器件已经开始批量生产，目前开发的新一代环形器复合陶瓷基板及半导体薄膜基板，已经取得一定的客户订单。

控股子公司拓瓷科技的多孔陶瓷、铝基碳化硅、金属基陶瓷复合材料等相关产品线逐步丰富，应用于半导体散热基板、3C

	终端壳体边框、新能源汽车轻量化制动系统的多款产品已完成送样工作，并取得阶段性进展。谢谢。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定沟通交流，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024年6月13日